

2025 年 9 月 8 日

第 37 期

总第 712 期

2025 年美国半导体产业现状

【译者按】今年 7 月，美国半导体行业协会发布 2025 年《美国半导体产业现状》。报告认为，美国半导体产业虽占据全球 50.4% 市场份额，但制造产能占比从 1990 年 37% 骤降至 2022 年 10%，面临技术领导力流失与供应链风险，政府通过持续政策支持和研究投资以维持创新与领导地位，应对全球竞争。报告认为，人工智能作为核心驱动力，加速产业变革，而美国在 IP、设计及设备领域保持领先，但材料严重依赖亚洲供应。为巩固技术领导地位，政策需聚焦制造激励、人才战略和供应链韧性。赛迪智库集成电路研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。

【关键词】美国 半导体 供应链 产业生态

一、引言

半导体是现代科技的奇迹，也是数字世界的基础。现代智能手机使用的芯片包含超过 150 亿个晶体管，每个晶体管比病毒还小，并且每秒能够开关数十亿次。当今人工智能数据中心的核心半导体可容纳数千亿个晶体管，数量之多，以至于假如每秒数一个晶体管，数完一颗芯片上所有的晶体管需要 6000 多年。

半导体基础技术是推动现代创新的隐形力量，也是先进半导体研究、设计和制造奇迹的明证。

2025 年，半导体已不仅是消费设备中的元件，更是构建美国未来的关键技术基石。从人工智能和量子计算，到先进的通信网络和防御系统，芯片已成为 21 世纪全球技术领先地位竞争的核心。

65 年前，美国工程师发明了半导体，如今，美国半导体产业依然称霸全球，并占据了全球芯片收入的 50% 以上。但是随着世界各地的竞争对手不断挑战美国的领先地位，美国在全球芯片制造产能中所占的份额急剧下降：从 1990 年的 37% 降至 2022 年的 10%。如果这一趋势持续下去，美国半导体产业恐将失去在制造工艺技术、设计与架构以及材料方面的领先优势，而这些优势对于开发下一代支撑未来技术的芯片至关重要。

幸运的是，具有里程碑意义的政府激励措施和研究投资帮助

扭转了这一局面，表明美国决心在这一关键领域重新巩固自身的领先地位。短短几年内，人们就看到了巨大的投资回报：已有 28 个州宣布了超过 100 个项目，私人投资总额超过 5000 亿美元。预计到 2032 年，这些项目将创造和支持超过 50 万个美国就业岗位，并将推动美国的芯片制造产能增加两倍。

目前，美国亟需制定健全的政府政策，以保障产业的增长和创新能力。美国政府及其他各国的决策正在重塑全球半导体产业格局。美国要想保住在芯片领域的领先地位，就必须在国内推行明智的税收、研究和劳动力政策，强化美国供应链，在全球市场中保持成本竞争力，并确保贸易和国家安全政策有的放矢，在不扼杀创新的前提下实现目标。当下的抉择不仅将塑造产业的未来，还将决定美国在世界上的地位。

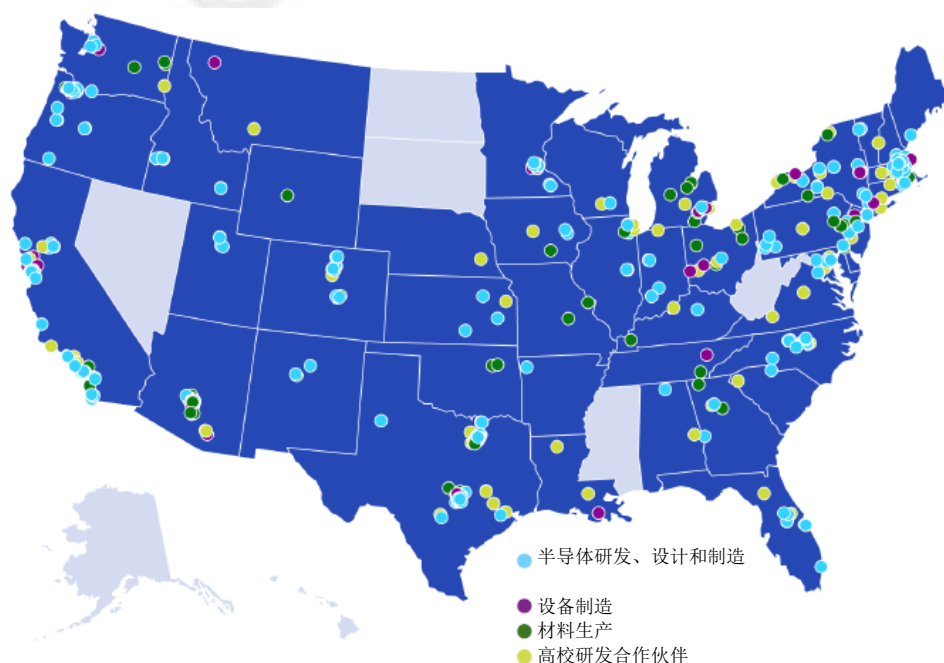
本报告简要介绍了 2025 年美国半导体产业现状：目前取得的进展、所面临的挑战，以及决定未来成败的关键。

二、美国的半导体生态系统

（一）生态系统地图与概览

美国的芯片制造激励措施和研发投入正在产生巨额回报，并强化了美国的半导体供应链。但要想保持和扩大上述投入、巩固美国在芯片设计领域的领先地位，并壮大美国的半导体劳动力队

伍，仍然任重而道远。

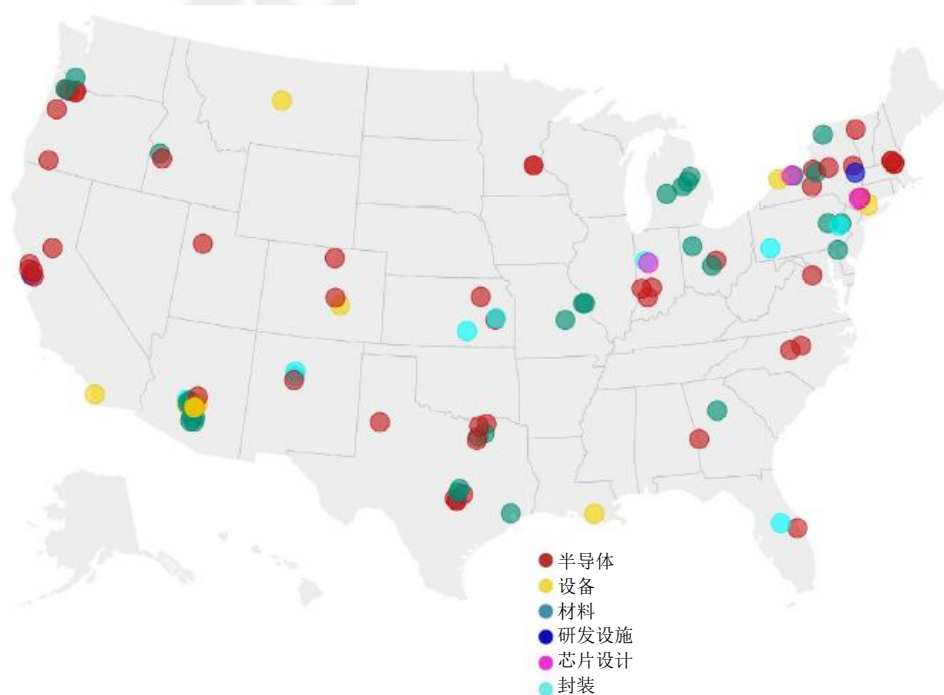


资料来源：美国半导体行业协会，《美国半导体生态系统地图》

图 1：2025 年美国半导体生态系统地图

半导体产业是世界上最先进的制造和研发领域之一。美国半导体生态系统地图展示了该产业的广度，包括研发机构、知识产权与芯片设计软件提供商、芯片设计企业、半导体制造工厂，以及半导体制造设备与材料供应商的生产基地（见图 1）。

半导体供应链投资地图显示了美国半导体产业近期的扩张情况（见图 2），所公布的投资总额超过 5000 亿美元，覆盖了 28 个州的 100 多个芯片生态系统项目。美国保持在半导体研究、设计、制造和供应商基础方面的全球领先地位，既是美国经济上的需要，也是涉及美国国家安全的重大议题。



资料来源：美国半导体行业协会，《美国的芯片复兴》

图 2：2020 年至 2025 年半导体供应链投资公告情况

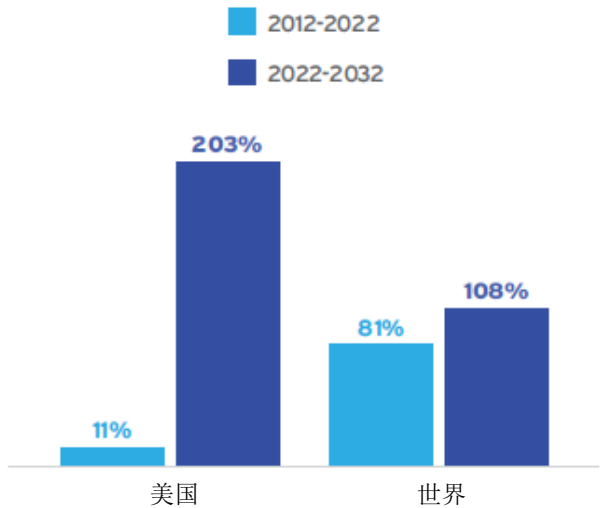
（二）制造

美国在全球芯片制造产能中所占的份额曾经历数十年的下降，如今，美国的半导体产业正通过大规模国内投资引领美国的再工业化进程。

2020 年特朗普总统第一任期内启动的关键芯片制造激励措施正在加速这一进程，扩大美国的半导体生态系统，并应对紧迫的经济与国家安全优先事项。

截至 2025 年 7 月，半导体生态系统内的企业已宣布超过 5000 亿美元的私营部门投资，用于振兴美国的芯片生态系统，预计到 2032 年，美国的芯片制造产能将增加两倍。这些项目预计将创造

和支持超过 50 万个美国就业岗位：半导体生态系统内的 6.8 万个设备岗位、12.2 万个建筑岗位，以及整个美国经济中超过 32 万个额外岗位。



资料来源：美国半导体行业协会/波士顿咨询公司

图 3：美国晶圆厂产能的预计增幅与世界平均水平（产能变化百分比）

为巩固以上成就，美国政府领导层于 2025 年 7 月通过立法强化了一项重要税收优惠：先进制造业投资税收抵免（AMIC），该项激励措施旨在帮助促进企业投资。新法律将先进制造业投资税收抵免的比率由 25% 提高到 35%。美国半导体行业协会也支持在该抵免政策于 2026 年到期后继续延长，并将其覆盖范围扩大到芯片研究和设计领域。此举将进一步加快美国的再工业化进程、刺激更多投资，并增强美国的全球竞争力（见图 3）。

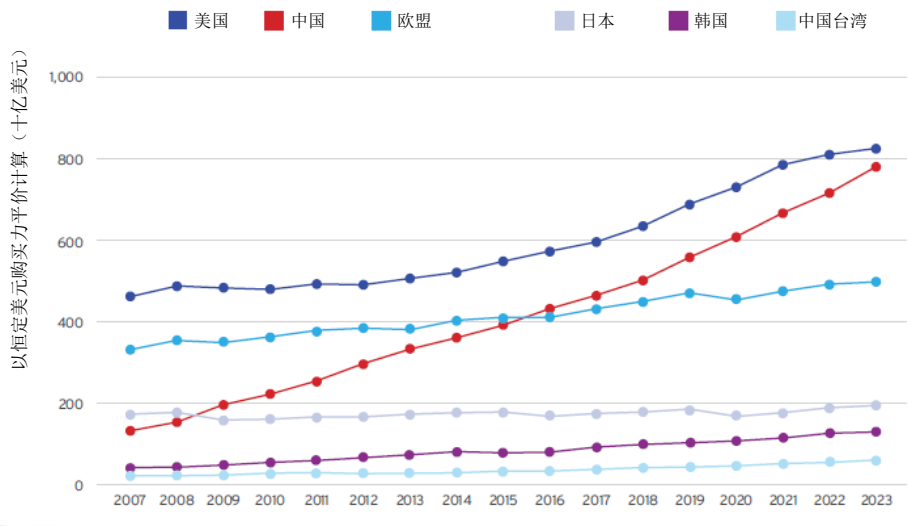
（三）研究

美国联邦研发投资正在构建框架，以保持和增强美国的技术

领先地位，强化研究人员与制造商之间的纽带，加速新的创新向商业或国防产品和应用的转化，其产生的效益将在整个经济中成倍放大，并加强美国的国家安全。

美联邦机构在半导体相关领域的基础和应用研究为创新与未来美国的半导体技术领先地位奠定了基础。

许多关键研究计划都是由美国国家科学基金会、国家标准与技术研究院和能源部科学办公室资助或运作，此外，还有许多由联邦资助的半导体研究项目，如美国国家半导体技术委员会、国家先进封装制造计划，以及与 Twins USA 合作的半导体制造和先进研究所（SMART USA）。

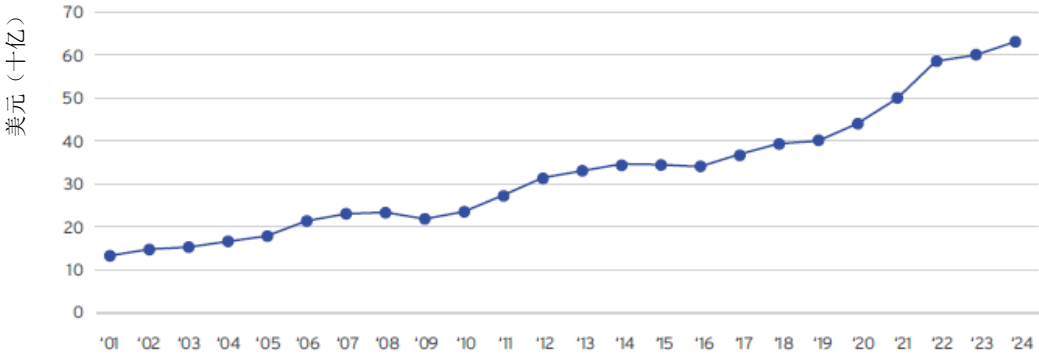


资料来源：经合组织

图 4：按企业总部所在地划分，2007 年至 2023 年年度研发支出

无论年销售周期如何变化，美国的半导体研发支出始终居高

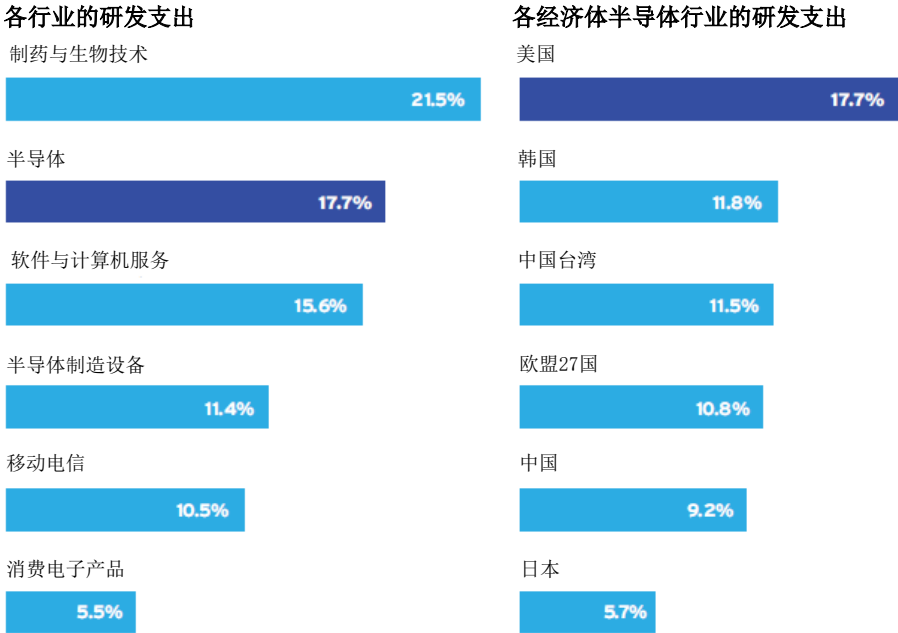
不下（见图 4），这反映了美国的市场份额领先地位、研究投资和持续创新之间的内在联系。



资料来源：美国半导体行业协会，《2025 年情况说明书》

图 5：2001 年至 2024 年总部位于美国的企业研发支出情况

2024 年，美国半导体产业的研发投资总额为 627 亿美元，与 2023 年研发支出相比，增加了约 5.7%（见图 5）。



资料来源：欧盟委员会，《2024 年欧盟工业研发投入记分牌》

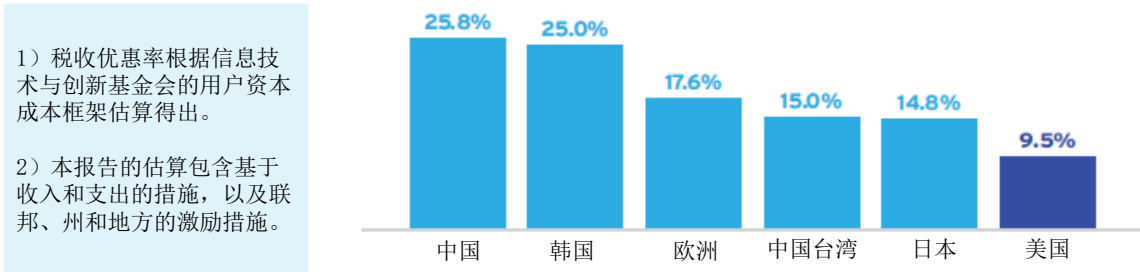
图 6：研发支出占销售额的百分比

美国半导体产业的研发投入占销售额的比例在全美各行各业中保持前列。

2024 年，半导体行业的研发投入占到总收入的 17.7%，这一比例仅次于制药和生物技术行业（见图 6）。尽管全球的竞争对手都在增加研发投入，并与美国展开产业竞争，但美国企业的研发支出仍然冠绝全球。这种极高的研发再投资水平推动了美国半导体行业的创新，反过来也有助于保持美国在全球销售市场的领先地位，并在全美范围内创造就业机会。

（四）设计

芯片设计是决定半导体器件功能和价值的重要研发活动，它使芯片得以接收、传输、处理和存储当今数字世界中日益增长的数据量。



资料来源：美国半导体行业协会/波士顿咨询公司

图 7：2022 年各地区的研发税收优惠率

（以百分比表示的各行各业的研发税收优惠率）

设计是一个高度复杂的跨学科过程，需要经年累月的研发、

数亿美元的投资，以及数以千计的工程师。随着芯片变得越来越复杂，尤其是采用尖端制程的芯片，开发成本不断攀升。

美国企业目前在芯片设计领域处于全球领先地位，但挑战已临近，各国政府都在鼓励芯片设计和研发，并试图取代美国的领先地位。美国目前在研发税收优惠率方面低于竞争对手(见图 7)。

如前所述，为确保美国成为企业投资半导体研发的理想目的地，美国国会应扩大现行的先进制造业投资税收抵免政策，使其覆盖范围涵盖芯片设计和研究领域。

销售是设计和研发投资的最终资金来源。确保市场尽可能地开放，将使美国的半导体设计领军企业受益，并保持其创新优势。

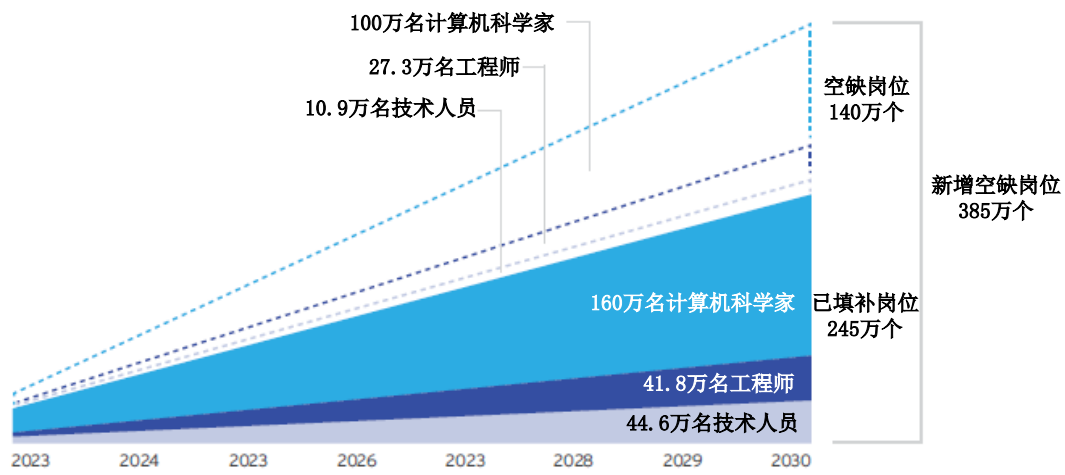
(五) 劳动力

熟练的国内劳动力对于保持美国在半导体领域的领先地位至关重要。

目前，美国的芯片产业直接雇佣了约 34.5 万人，分布在芯片设计、电子设计自动化、半导体制造和设备生产等领域(见图 9)。除此之外，半导体还支撑了 300 多个下游产业。

在未来几年，随着美国半导体生态系统的发展，将需要更多的合格劳动力来填补空缺岗位。美国半导体行业协会-牛津经济研究院的一项研究表明，美国面临着技术人员、计算机科学家和工程师的严重短缺，预计到 2030 年，半导体产业的岗位缺口将达

到 6.7 万个，而在整个美国经济中，上述劳动力缺口将达到 140 万个（见图 8）。



资料来源：国际消费电子展、季度就业和工资普查、牛津经济研究院

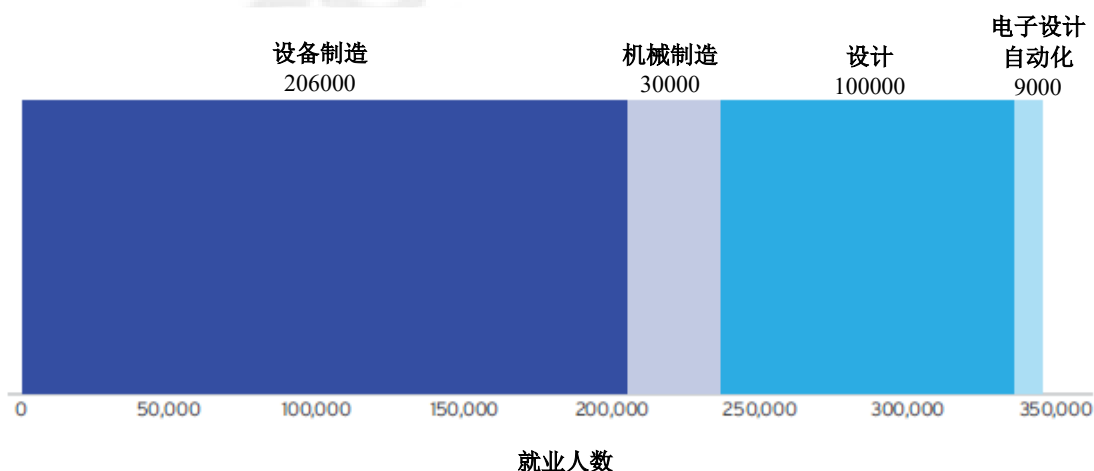
图 8：2023 年至 2030 年整个经济领域的劳动力缺口

（预计美国对计算机科学家、工程师和技术人员的需求）

为应对这一人才挑战，美国政府和产业界应通力合作，在持续推进产业劳动力发展的基础上，扩大美国的理工科毕业生数量，并留住和吸引更多来自世界各地的顶尖工程专业学生。

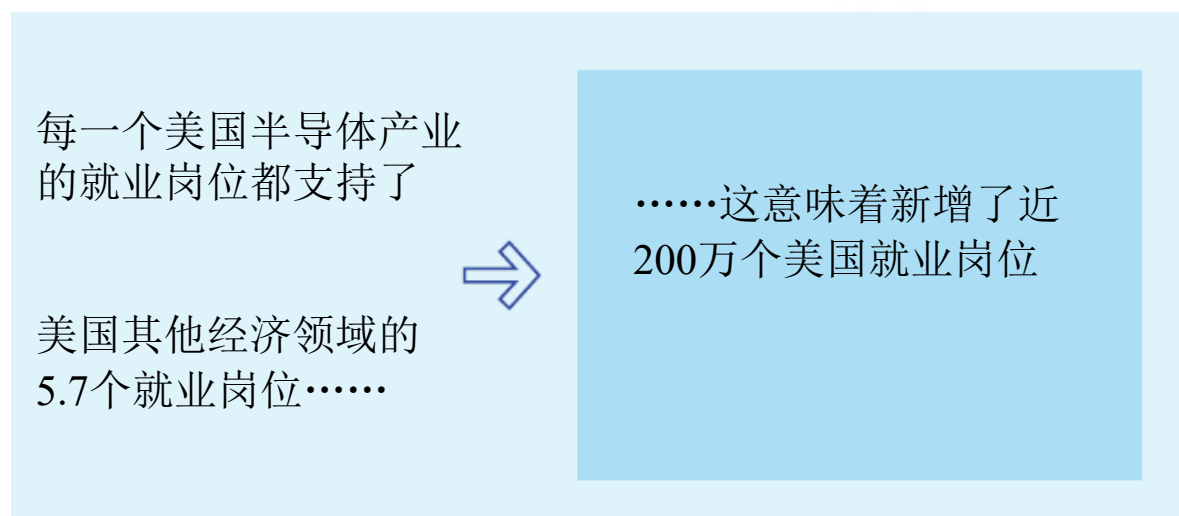
具有竞争力的国内劳动力和具有韧性的制造能力对美国半导体产业的领先地位至关重要。此外，强大的国内半导体产业对美国的经济和国家安全也至关重要。

美国半导体产业创造了约 34.5 万个直接就业岗位，以及近 200 万个间接和衍生岗位（见图 9、图 10）。



资料来源：国际消费电子展、季度就业和工资普查、牛津经济研究院

图 9：2024 年美国半导体各领域劳动力分布情况



资料来源：美国半导体行业协会，《2025 年情况说明书》

图 10：美国半导体产业创造了近 200 万个间接岗位

三、美国的半导体供应链

（一）争夺全球半导体领先地位

各主要经济体的政府纷纷实施大量财政激励措施和一系列其

他支持，以强化本地的半导体生态系统，力图在半导体制造和芯片设计方面获得成本优势（见表 1）。

美国必须持续推动政府和私营部门对半导体产业的投资，以确保在未来的技术竞争中获胜。

为克服长期以来的成本劣势，美国政府必须采取适当的税收和其他激励措施，以推动对本国半导体生态系统的未来投资。

表 1：2024 年各主要经济体的政府激励措施示例

	美国	中国	欧盟	日本	韩国	中国台湾
目标	强化半导体供应链的韧性	到 2025 年，芯片自给率达到 70%	到 2030 年，占据全球 20% 的份额	到 2030 年，实现 1120 亿美元的销售额	在逻辑芯片领域站稳脚跟，巩固晶圆厂的领先地位	到 2030 年，突破 1 纳米制程
指导政策	《芯片与科学法案》	“十四五”规划：《国家集成电路产业发展推进纲要》 《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	《2030 年数字化指南针》	《半导体与数字产业战略》	《K-带半导体战略》	登月计划：《埃米半导体倡议》 《产业创新条例》

	美国	中国	欧盟	日本	韩国	中国台湾
主要激励措施金额	130 亿美元的拨款; 35% 的先进制造业投资税收抵免。	超过 2000 亿美元的补贴; 针对芯片研发的 220% “超级扣除”。	470 亿美元的补助。	175 亿美元的补助。	550 亿美元的税收。	160 亿美元的税收优惠。
关键举措	《芯片与科学法案》的补助和州一级的支持	“国家集成电路产业投资基金”一期、二期和三期; 国家级、省级、市级集成电路专项基金; 国有企业领军者; 国家自然科学基金、国家创业投资引导基金、国家人工智能产业投资基金。	《欧盟芯片法案》的补助和贷款; 国家援助津贴。	国家财政拨款; 尖端半导体技术中心; 特定半导体资助计划和补贴。	韩国版《芯片法案》下的税收优惠; 公私合作教育项目。	芯片创新计划的财政补贴; 产学研合作、税收抵免。

资料来源：高德纳咨询公司；美国半导体行业协会；新闻稿；企业披露；各国政府网站；波士顿咨询公司分析

（二）半导体贸易

半导体产业早已高度全球化，涵盖数十个国家和数千家供应商。

美国半导体产业的发展与活力取决于本国企业满足海外需求的能力。

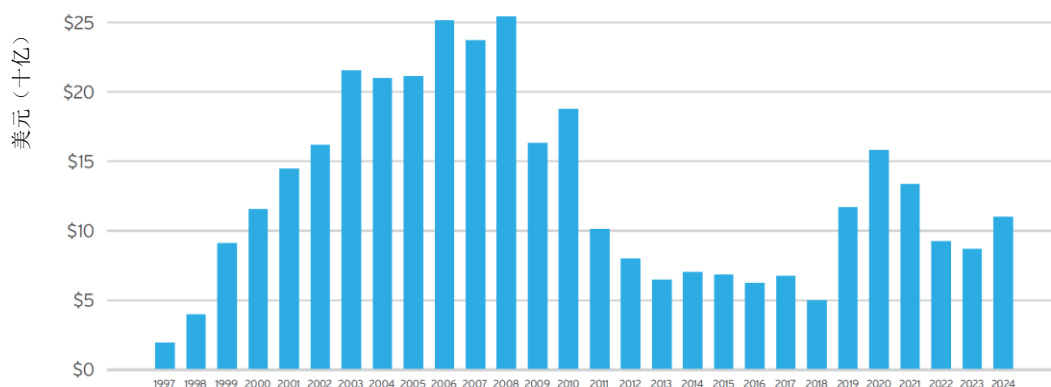
美国半导体产业约 70% 的收入来自海外销售。为保证并支持对美国半导体生产的长期资本密集型投资，芯片制造商需要确信，其产品除仰仗强劲的国内需求外，还能进入全球市场且拥有全球客户群。

为保持美国在半导体领域的领先优势（这也支撑着美国在人工智能、汽车、通信、医疗、国防和航空航天等关键下游技术领域的领先地位），美国必须推进贸易谈判及其他经济措施和举措，以：

- 确保本国半导体生产的成本效益；
- 提振下游需求；
- 扩大美国芯片在全球的市场基础。

半导体向来是美国的主要出口商品，近三十年来一直保持着贸易顺差（见图 11）。推动就半导体技术及关键下游产品达成行业性安排，将提振对美国芯片的需求，并有助于构建更安全、更稳定的供应链。同时，与合作伙伴共建能够补充和支持美国产业

运营的供应链能力，包括针对上游半导体材料（比如关键矿物和专用化学品）的多元化且安全的采购替代方案，将使美国的产业更加壮大。



资料来源：美国国际贸易委员会，数据网站，2025 年 3 月 4 日获取

图 11：1997 年至 2024 年的美国半导体贸易顺差额

（基于协调关税表标题 8541 不包括太阳能产品和 8542）

（三）美国半导体产业对国内经济的贡献

半导体仍是美国最主要的出口产品之一。

过去几十年，美国半导体产业在全球市场上一直处于领先地位，目前美国在全球芯片销售中占据 50.4% 的市场份额（见图 15）。2024 年，美国半导体出口总额达 570 亿美元，位居出口品类的第六名，排在成品油、原油、飞机、天然气和汽车之后（见图 12）。

与整个半导体市场的增长情况类似，2024 年美国的芯片出口增长了 13%，这使该产业保住了第六大出口品类的地位。放眼未来，美国芯片产业的增长前景向好，预计 2025 年将实现两位数

的增长。

展望未来，大规模国内投资将继续带动本国产业的产能增加，从而提升美国半导体的出口潜力。



资料来源：美国国际贸易委员会，数据网站，2025 年 3 月 4 日获取

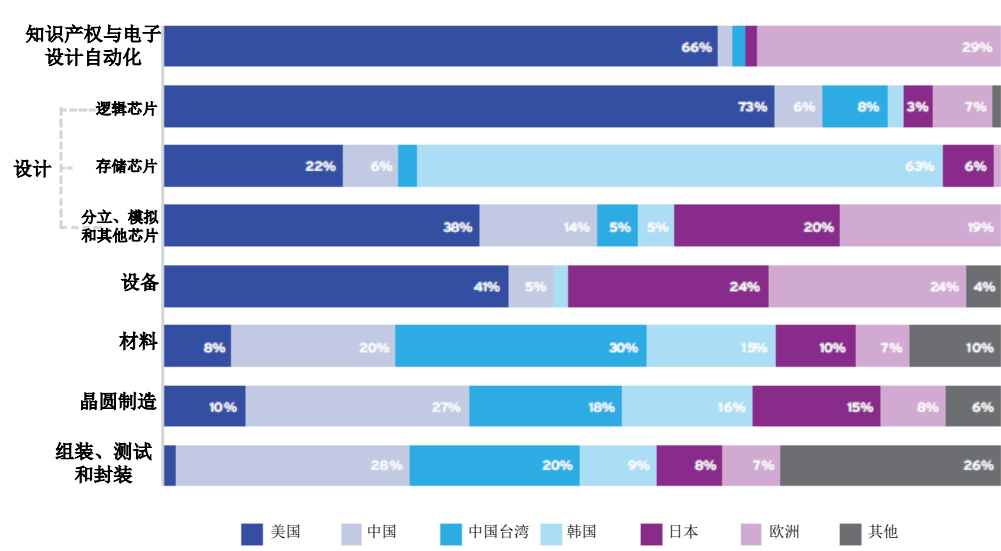
图 12：美国出口情况：基于出口总额

（使用“北美产业分类体系”国家行业代码）

（四）各个国家和地区的供应链增加值

美国半导体行业协会-波士顿咨询公司 2024 年的一份报告揭示了全球半导体供应链的专业化程度。例如，总部位于美国的企业在设计与核心知识产权方面遥遥领先，并在半导体制造设备领域占据近一半的全球市场份额，其余的份额也大多掌握在美国的盟友，包括荷兰和日本，这些国家的企业都在美国开展了大量的制造和研发活动。半导体制造设备和建筑系统占据了晶圆厂建设

成本的大头。对于半导体制造中使用的材料，比如，裸晶圆和外延晶圆、光刻胶、光掩模、电子气体、湿电子化学品、封装基板、引线框架等，美国半导体制造商主要依赖来自中国台湾、日本、韩国和中国大陆的供应商。确保美国产业在获取制造工具和材料方面具有成本竞争力，对于支持对国内芯片产能的持续投资至关重要。



资料来源：IPnest；沃尔夫研究公司；高德纳咨询公司；国际半导体产业协会；波士顿咨询公司分析

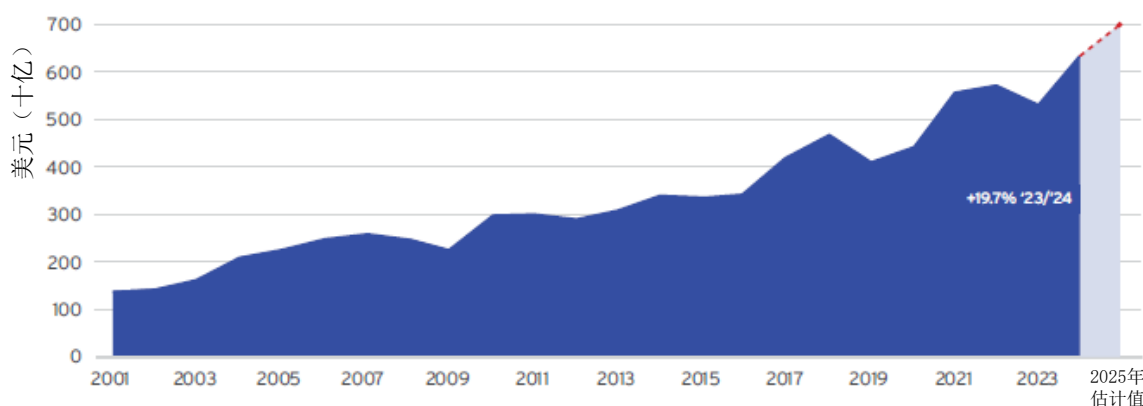
图 13：按活动和地区划分，2024 年半导体产业增加值（百分比）

四、美国在全球半导体市场的份额

（一）全球半导体销售额

过去三十年间，半导体产业快速增长，并产生了巨大的经济影响。

芯片性能提升和成本优化推动了 20 世纪 90 年代大型计算机向个人电脑的演变，2000 年代网络 and 在线服务的发展，以及 2010 年代的智能手机革命。展望未来，人工智能、电动汽车和自动驾驶，以及先进制造业（所有这些都依赖于半导体）的发展将在未来十年间推动半导体市场的扩张。预计到 2030 年，仅人工智能一项就将为全球经济贡献超过 15 万亿美元。半导体对现代社会至关重要，这也是对半导体的长期市场需求保持强劲的原因。



资料来源：世界半导体贸易统计机构

图 14：2001 年至 2025 年（估计值）全球半导体销售额

2024 年全球半导体销售额达到 6305 亿美元，超出了最初的预测，且首次突破了 6000 亿美元大关（见图 14）。就地区来看，2024 年，美国、中国和亚太与其他地区的销售额均有所上升，分别增长了 45.2%、20.0%和 12.2%，而日本和欧洲则有所下降，分别降低了 0.3%和 8.1%。

2024 年，与高性能计算相关的几个半导体产品细分市场表现优异。其中，逻辑芯片产品的销售额达到 2158 亿美元，成为了销售额占比最大的产品类别。存储芯片产品的销售额达到 1655 亿美元，增长了 78.9%，位列第二。作为存储芯片的一个子类，动态随机存储芯片产品的销售额增长了 82.6%，是增幅最高的产品类别。

2024 年的全球销售额显著高于 2023 年，每个月的销售与去年同月相比，均至少增长了 15%。这主要归功于人工智能、汽车和工业应用领域芯片需求的增加。但是，成熟制程芯片的出货收入从 2023 年到 2024 年下降了 7.4%。总体而言，2024 年全球半导体的销售额较 2023 年增长了 19.7%（见图 14）。

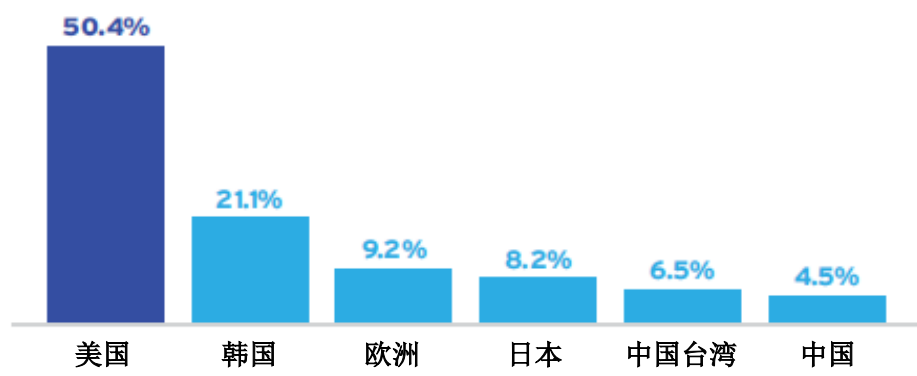
世界半导体贸易统计机构预估，2025 年全球半导体产业销售额将增至 7010 亿美元，较 2024 年增长 11.2%。

（二）美国的市场份额

美国半导体产业占据了全球市场的半壁江山，并且每年都在稳步增长。

自 20 世纪 90 年代后期以来，美国一直是全球芯片销售市场份额的引领者。2024 年，美国半导体产业延续了这一趋势，总部位于美国的企业销售额高达 3180 亿美元，占全球销售收入的 50.4%（见图 15）。此外，美国半导体企业在研发、设计和制造工艺技

术方面或遥遥领先，或具备强大的竞争力。



资料来源：世界半导体贸易统计机构、高德纳咨询公司、Omdia 和美国半导体行业协会的估算

图 15：按企业总部所在地划分，全球市场占比情况



图 16：良性创新循环

这种领先地位也使得美国半导体产业受益于良性创新循环。在全球销售额中的领先地位推动了研发投入，反过来又加大了美国的技术优势，进而又巩固了美国作为全球销售领跑者的地位。只要美国半导体产业能够保持全球市场份额的领先地位，就将继

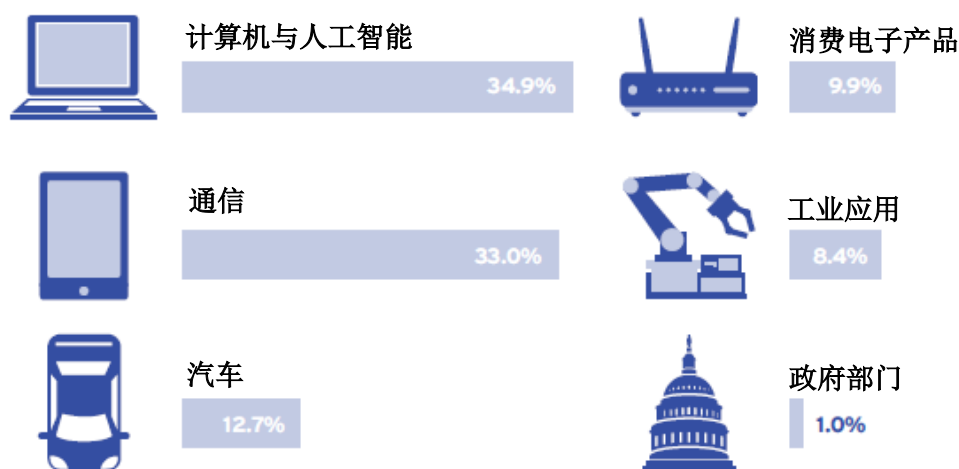
续从这一良性创新循环中受益（见图 16）。

（三）半导体需求的驱动因素

未来十年，半导体技术的持续创新将推动一系列变革性技术的进步，包括人工智能、5G/6G 通信、量子计算、先进制造、机器人技术和其他技术。事实上，半导体需求的长期增长动力已稳固确立。

2024 年半导体的销售额增长源于人工智能系统关键芯片销售量和需求的增加。这些需求驱动因素的变化引发各市场部门在全球销售收入的占比重新洗牌。其中最显著的，计算机市场的芯片销售份额较 2023 年增长了 10%，成为 2024 年最大的细分市场（见图 17）。其他细分市场表现各异：通信、消费电子产品和政府部门出现增长，而汽车与工业应用行业则有所下降。半导体需求持续强劲增长，全球销售额有望在 2030 年前后突破万亿美元大关。为满足未来十年日益增长的芯片需求，半导体供应链上的企业已承诺对美国追加超过 5000 亿美元的新投资。

人工智能领域的各种创新在 2023 年加速爆发，并一直持续到 2024 年，这推动了半导体相关需求的增长。计算机终端市场的半导体收入也因此得到了提升。



资料来源：世界半导体贸易统计机构，《2024 年最终用途调查》

图 17：按最终用途划分，2024 年全球总需求占比情况

展望未来，随着新的应用不断涌现，以及终端客户越来越多地受益于新开发的服务，预计在 2025 和 2026 年，对人工智能相关半导体器件的需求将持续走强。

（四）美国半导体产业推动人工智能的发展

人工智能正彻底改变各个核心经济领域，包括：医疗、农业、国防、通信、制造、交通运输等领域。

半导体技术构成了支撑人工智能系统的计算、存储和网络骨干。单台人工智能服务器中包含来自半导体技术堆栈的数千颗芯片：中央处理器、高带宽存储器、互连与网络芯片、电源管理芯片、模数与数模转换器，等等。所有这些芯片均围绕着人工智能加速器工作，比如图形处理器、专用集成电路或现场可编程门阵列。

这些芯片为大规模训练和部署复杂人工智能模型提供了所需的算力。整个半导体供应链共同支撑着人工智能系统。

随着人工智能持续推动芯片需求增加，并不断为各个经济部门带来变革，强化半导体能力对于充分释放人工智能技术的潜力将至关重要，并将有助于保持美国的全球技术领先地位。

五、政策议程：赢得芯片竞争

成功的美国半导体产业是加强美国国家安全和制造业的坚实基础，也是提升美国全球竞争力并取得胜利的重要前提。

半导体制造激励措施和研发投入：推进对美国芯片制造的激励措施和对美国创新的投资，保持美国半导体产业的全球竞争力。

税收：确保美国成为投资半导体研究、设计和制造的理想税收目的地。

研究：支持现有的研发计划，并增加美国联邦对半导体研究和物理科学基础研究的投资，以巩固美国的技术领先地位，并赢得未来的技术竞争。

劳动力和移民：通过培养、吸引和留住高技能劳动力来扩大美国的人才储备。

贸易与供应链韧性：恢复美国的贸易领先地位，构建强大且互补的全球芯片供应链，并不断拓展新兴市场。

出口管制与技术限制：确保政策有的放矢，具有针对性和有效性，并且不会损害本该保护的利益。

环境与能源监管：简化监管和审批要求，促进创新和产业增长，保护劳动者和环境，并扩大美国在国内和国际上的能源优势。

六、本报告的研究方法

本报告基于美国半导体行业协会独立采集的数据，并与波士顿咨询公司和牛津经济研究院合作完成。有关产业就业情况的数字来自美国人口普查局和美国劳工部的数据。有关产业国际贸易活动的数字来自对美国国际贸易委员会官方贸易数据的分析。有关产业制造、产能和资本支出的数字来自 TechInsights、纽约大学、麦肯锡、《经济学人》、东电电子、摩根大通和 IC Insights 的数据。市场数据来自世界半导体贸易统计机构的数据。产业研发数据来自企业财报和纽约大学的数据。有关产业就业乘数、国内生产总值贡献和劳动收入的数据来自经济分析模型“规划影响分析”（IMPLAN）开发的投入产出模型。

七、关于美国半导体行业协会

半导体产业是美国最大的出口产业之一，也是美国经济实力、国家安全和全球竞争力的重要驱动因素，美国半导体行业协会则是半导体产业的代言人。半导体，这些赋能现代技术的微型芯片

驱动着令人难以置信的产品和服务，改变了人们的生活和经济。半导体产业在美国直接雇佣了 30 多万名员工，2024 年美国半导体产业总销售额达 3180 亿美元。

美国半导体行业协会成员占美国半导体产业总销售额的 99%。通过该联盟，美国半导体行业协会致力于与国会、政府部门及全球主要产业利益相关方合作，推动能够促进创新、业务发展和国际竞争的政策，从而增强美国在半导体制造、设计和研究领域的领先地位。

译自： *State of the U.S. Semiconductor Industry 2025, July 2025 by Semiconductor Industry Association (SIA)*

译文作者：赛迪工业和信息化研究院 薛金鑫
联系方式：13051727966
电子邮件：xuejinxin@ccidthinktank.com

咨询翘楚在这里汇聚

规划研究所

工业经济研究所

电子信息研究所

集成电路研究所

产业政策研究所

科技与标准研究所

知识产权研究所

世界工业研究所

无线电管理研究所

信息化与软件产业研究所

军民融合研究所

政策法规研究所

安全产业研究所

网络安全研究所

中小企业研究所

节能与环保研究所

材料工业研究所

消费品工业研究所

编辑部：工业和信息化部赛迪研究院

通讯地址：北京市海淀区万寿路27号院8号楼12层

邮政编码：100846

联系人：王 乐

联系电话：010-68200552 13701083941

传 真：010-68209616

网 址：www.ccidwise.com

电子邮件：wangle@ccidgroup.com

报：部领导

送：部机关各司局，各地方工业和信息化主管部门，
相关部门及研究单位，相关行业协会

编辑部：赛迪工业和信息化研究院

通讯地址：北京市海淀区紫竹院路 66 号赛迪大厦 8 层国际合作处

邮政编码：100048

联系人：袁素雅

联系电话：（010）88559543 13263204219

传 真：（010）88558833

网 址：www.ccidgroup.com

电子邮件：yuansuya@ccidthinktank.com

